



新聞稿

中芯国际与美国 ChipPAC 合作封装及测试芯片

(二零零二年二月六日--- 上海) 上海实业控股有限公司(“上实控股”)参予投资的中芯国际集成电路制造有限公司与美国 ChipPAC 公司共同宣布建立互不排除联盟 (Non-Exclusive Alliance), 目的是为中国及全世界的客户提供全方位的服务, 包括晶圆代工, 封装测试, 以及最终销售服务。两家公司的合作领域包括芯片测试以及半导体产品封装测试。ChipPAC 是全球最大的半导体封装测试服务商之一, 提供全面多样的技术服务。中芯国际位于中国上海, 是中国第一家拥有世界级先进技术的芯片加工厂。

中芯国际于 2001 年完成了第一期筹资, 总金额包括超过十亿美元资本投资以及来自四家中国本地银行的四亿八千万美元贷款。中芯近期已进入试产阶段, 制造 0.25 微米以下工艺 8 英寸晶圆, 同时中芯希望在 2004 年年底达到最大产能, 月产 85,000 片 8 英寸晶圆。量产初期中芯预期将会生产包括静态存储器 (SRAM), 特定用途集成电路存储器 (ASIC RAM), 逻辑电路 (LOGIC), 以及其它类型的集成电路, 产品将广泛应用于数码电视, VCD/DVD, 手提电话, IC 智能卡等各个领域。

ChipPAC 公司主席兼总裁 Dennis McKenna 说: “我们早在七年前就基于中国市场发展前景而决定投身其中。现在来看, 我们当时的决策是正确的。而今, 中芯国际在芯片加工产能上的承诺进一步证明了中国市场的成长潜力。ChipPAC 希望通过与中芯国际建立的伙伴关系, 为我们的客户提供全方位的半导体制造服务。迄今为止我们已经在中国投资一亿五千万美元, 并将在未来三年里实现两倍于此的投资, 为实现中国半导体产业年复合成长率 18% 的目标而努力。ChipPAC 目前的生产能力超过我们最大的竞争者三倍以上。”

中芯国际总裁兼执行长张汝京表示, “我们的目标是成为服务中国及全球市场的一流芯片代工厂。目前我们已经进入量产, 我们的客户期待发展高效可靠的生产供应链, 所以拥有像 ChipPAC 这样的伙伴对于我们而言是极为关键的, 因为无论在规模, 经验, 以及绩效表现等方面 ChipPAC 都能够给我们届时所需的足够支持。ChipPAC 的信誉以及过去五年在中国的成功经验有目共睹, 我们衷心期待同 ChipPAC 建立长期合作关系。”

ChipPAC 从 2001 年开始在中国发展生产业务，产品包括芯片级封装以及 EconoCSPs。为满足手提电话制造商等客户的需要，ChipPAC 开发了一整套产品管道，包括从 1.2mm 相同芯片堆迭式芯片级封装到混合三至四种芯片的芯片级封装，目前各种芯片级封装技术正在验收过程当中。在中国，公司业已将产品领域扩展至消费性产品，比如 DVD 市场中的 QFP 和 TQFP 封装技术，以及模拟市场的 SSOP，TSSOP 和其他 SOIC 封装技术。所有这些产品都将有测试服务来支持，同时支持计算机工业，因为尽管世界总体增长率不会超过 10%，中国计算机工业的年复合增长率将达到 23%。ChipPAC 还将投身其它领域，包括高级封装技术以及创新应用，比如将 BGA 技术引进中国用于绘图芯片和芯片组的封装测试。

上实控股于 2001 年 4 月及 9 月先後两次注资，共投入 1.84 亿美元，占中芯国际 17% 股权，是该公司最大单一股东。

完

媒介查询： 上海实业控股有限公司
企业传讯部
冯启明 (电话：2821-3919, 电邮：fungkm@sihl.com.hk)

中芯国际网址： <http://www.smics.com.cn>

ChipPAC 公司网址： <http://www.chippac.com>